

<<印制电路板技术标准手册>>

图书基本信息

书名：<<印制电路板技术标准手册>>

13位ISBN编号：9787506643597

10位ISBN编号：7506643596

出版时间：2007-4

出版时间：中国标准

作者：王健石

页数：528

字数：793000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<印制电路板技术标准手册>>

内容概要

本手册荟萃了50多项印制电路板国家标准和行业标准的相关内容，主要包括印制电路板设计、制图、规范，印制电路板材料和连接器，印制电路板加工工艺、测试方法和检验方法等，全面系统地介绍了印制电路板专业最新技术资料 and 标准化成果。

本手册内容丰富实用，技术数据可靠，使用方便，读者可通过本手册迅速准确地查阅所需技术内容。

本手册是印制电路板专业必备的工具书，可供印制电路设计、工艺、生产、检验、使用的广大工程技术人员和相关管理人员使用。

<<印制电路板技术标准手册>>

书籍目录

第1章 印制电路板设计 1.1 印制板的设计和使用 1.2 印制电路板设计规范 1.3 印制板安装用元器件的设计和使用指南 1.4 印制底板组装件设计要求 参考资料第2章 印制电路板制图 2.1 印制板制图 2.2 印制电路板图数据格式Gerber 2.3 印制电路用照相底图图形系列 2.4 彩色电视广播接收机印制板制图 参考资料第3章 印制电路板规范 3.1 印制板总规范 3.2 无金属化孔单双面印制板分规范 3.3 有金属化孔单双面印制板分规范 3.4 印制板组装分规范表面安装焊接组装的要求 3.5 印制板组装分规范通孔安装焊接组装的要求 3.6 印制板组装分规范引出端焊接组装的要求 3.7 多层印制板分规范 3.8 有贯穿连接的刚挠多层印制板规范 参考资料第4章 印制电路板材料 4.1 印制电路用覆铜箔层压板通用规则 4.2 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板 4.3 印制电路用覆铜箔环氧纸层压板 4.4 印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板 4.5 印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜 4.6 印制电路用挠性覆铜箔聚酯薄膜 4.7 多层印制电路用限定燃烧性的薄覆铜箔聚酰亚胺玻璃布层压板 4.8 印制电路用限定燃烧性的覆铜箔聚酰亚胺玻璃布层压板 4.9 限定燃烧性的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板 4.10 一般用途的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板 4.11 印制板用漂白木浆纸 4.12 挠性印制电路用涂胶聚酯薄膜 4.13 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法 4.14 印制板组装件涂覆用电绝缘化合物 参考资料第5章 印制电路板加工工艺 5.1 印制电路板孔金属化工艺技术要求 5.2 印制电路板电镀锡铅合金工艺技术要求 5.3 印制电路板计算机辅助设计光绘照相原版技术条件 5.4 印制电路生产用照相底版的技术条件和制作方法 5.5 印制板组装件装联技术要求 5.6 表面和混合安装印制电路板组装件的高可靠性焊接 5.7 印制电路组件装焊后的清洗工艺方法 5.8 印制电路板照相底图的技术要求和制作方法(手工贴图) 参考资料第6章 印制电路板连接器 6.1 CY251型印制电路连接器 6.2 CH1型印制电路连接器第7章 印制板测试方法和检验方法 参考文献

<<印制电路板技术标准手册>>

编辑推荐

《印制电路板技术标准手册》是印制电路板专业必备的工具书，可供印制电路设计、工艺、生产、检验、使用的广大工程技术人员和相关管理人员使用。

<<印制电路板技术标准手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>